

小型モジュール向け EEPROMソリューション



超小型WLCSP & DFNパッケージ・ラインアップ

STは、サイズ1mm²未満、厚さわずか0.3mmの超小型EEPROMデバイスを広範な容量サイズに対応する充実したラインアップで提供しており、PCBフットプリント全体の中でほとんど見えないほどの大きさでありながら、パラメータ管理の柔軟性を保証しています。

I²Cインターフェースを備えたデバイスを5ピンDFNパッケージまたは4ボールWLCSPに小型化することができます。

これらの超薄型デバイスは、あらゆるPCB上のごくわずかなスペースに収まり、重さは1mg未満で、超軽量アプリケーションに最適です。

特徴

- DFN-8小型プラスチック・パッケージ
 - 本体サイズ：2 x 3mm
 - 厚さ：0.55mm
 - 重量：16mg
- DFN-5小型プラスチック・パッケージ
 - I²C用のみ提供
 - 本体サイズ：1.4 x 1.7mm
 - 厚さ：0.55mm
 - 重量：6mg
- 4ボール / 8ボールWLCSP
 - サイズ：わずか0.76mm² (4ボールWLCSPの128Kbit I²Cバージョン)
 - 厚さ：0.3 ~ 0.6mm
 - 裏面コーティング・オプション
 - 重量：1mg未満

利点

- DFN-8 & DFN-5
 - 小型PCBフットプリント
 - 堅牢性の高いパッケージ、取り扱いが容易
- WLCSP
 - 最小のフットプリントでPCBサイズを削減
 - 超薄型モジュール用の設計
 - 最軽量

アプリケーション

- ヘッドセット
- 補聴器
- Wi-Fi / Bluetooth Low Energy モジュール
- カメラ・モジュール
- ウェアラブル
- GPS
- ドローン
- 高度なデジタル・コアと厳しいスペース制約が求められるあらゆるモジュール

超小型モジュール用ポートフォリオ

パッケージ	シリアル インタフェース	1 Kb	2 Kb	4 Kb	8 Kb	16 Kb	32 Kb	64 Kb	128 Kb	256 Kb	512 Kb	1 Mb	2 Mb
4ボール WLCSP 厚み : 0.3mm ピッチ : 0.4mm 重量 : <1mg	I ² Cのみ				0.53 mm ²	0.63 mm ²	0.76 mm ²	0.76 mm ²	0.76 mm ²				
DFN-5 サイズ : 1.7 x 1.4 mm 厚み : 0.55mm ピッチ : 0.4mm 重量 : 6mg	I ² Cのみ		•	•	•	•	•	•	•				
8ボール WLCSP 厚み : 0.58mm ピッチ : 0.4mm 重量 : 約1mg	I ² C							1.1 mm ²	1.5 mm ²	1.8 mm ²	2.5 mm ²	4.5 mm ²	7.3 mm ²
	SPI							1.1 mm ²	1.5 mm ²	1.8 mm ²	2.5 mm ²	4.5 mm ²	7.3 mm ²
DFN-8 サイズ : 2 x 3 mm 厚み : 0.55mm ピッチ : 0.5mm 重量 : 16mg	I ² C		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SPI		•	•	•	•	•	•	•	•	•		

全製品のV_{cc}は1.7 ~ 5.5Vで、動作温度範囲は-40 ~ +85°Cです。



DFN-8



DFN-5



8ボール WLCSP



4ボール WLCSP



詳細情報およびサンプルについては、STウェブサイトをご覧ください。 <http://www.st.com/standardeeprom>